

技術情報シート

1. 技術の名称	各種(半導体、液晶、有機 EL、太陽電池等)製造装置用パーツの貴金属リサイクル
2. 技術の内容	半導体製造工程等で使用しているパーツから貴金属のリサイクルが可能となります。 パーツも基材を傷めずに洗浄再生する事で、新品購入削減に貢献致します。
3. 技術の概要	【技術の目的・用途】 半導体製造工程等では配線材料等に Au、In 等の貴金属を使用しています。この貴金属が付着したパーツを効率よく洗浄する事で、貴金属の高収率リサイクルを実現しています。また洗浄したパーツも基材を傷めず、清浄度の高い洗浄を実施する事でパーツのリユース、お客様製造工程の高歩留を実現しています。 リサイクルフロー <pre> graph LR A[貴金属付着パーツ] --> B[洗浄] B --> C[貴金属を含む洗浄残渣] B --> D[洗浄パーツ] C --> E[精製] E --> F[貴金属] D --> G[お客様にて再度ご使用] </pre> 【技術の特長】 ① パーツの母材を傷めずに貴金属をリサイクル ② パーツ表面の微細な付着物、金属成分を除去（低パーティクル、メタル化） 【実績】 半導体、FPD 等、各種製造メーカー様 【価格又はその問い合わせ先】 お問合せ先：株式会社新菱 セミコンテクノ事業部門 企画営業部 担当 小西 伸清 電話番号 093-643-2778 Mail 6008513@shinryo-gr.com
4. 技術の分類	
①用途分類	リサイクル(マテリアル)
②対象廃棄物	電子製品
③提供役務	その他
5. 本技術に関するサービス提供が可能な国	中国、台湾
6. 検索キーワード	貴金属、リサイクル、ウェハ、再生、パーツ、洗浄、精密洗浄、リコート、表面処理、溶射、アルマイト
7. 問合先窓口・担当者	上記 3. 【価格又はその問い合わせ先】をご参照下さい。